

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2015-34

# 广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一五年六月

## 发行人声明

广东德豪润达电气股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本预案的真实性、准确性、完整性负责并承担相应的法律责任。

本公司及董事会对本预案所披露的信息承担个别和连带的法律责任。

本公司及董事会对本次非公开发行股票后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者若有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他相关专业顾问。

本预案所述本次非公开发行股票事项的生效和完成尚待中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其它政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

## 特别提示

1. 广东德豪润达电气股份有限公司本次非公开发行股票的相关事项已经第五届董事会第十一次会议决议通过,并与本次发行相关的股东大会,公司将于召开股东大会,并作出书面决议。

2. 公司第五届董事会第十一会议审议通过了《2014年年度非公开发行预案》,根据《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的规定,公司的董事会在未来的发展规划及公司的状况,2014年拟以公司未来三年未分配利润139,640万元为基数,每10股派发现金股利3元(含税),共派发现金股利1,489,200万元(含税),2014年不送股,也不转股,并不存在公积金转增股本的情况。

3. 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资者、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、个人投资者等不超过10名(含10名)特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的只以现金认购的,视为一个发行对象;信托投资者作为发行对象的,只能以其现金认购的,所发行的认购对象以现金方式购买发行的股份,其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购金额不得超过20,000万元,超过部分的认购对象为无关联方。

4. 本次非公开发行股票的数量不超过37,847万股(含37,847万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项时,将根据除权除息后的发行价格进行调整。

5. 本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日(即2015年6月13日),根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%确定(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量),本次发行的价格定格为不低于11.89元/股。

6. 公司第五届董事会第十一会议在表决本次非公开发行股票的议案时,除出席该会议的股东外,其余股东回避表决,本次非公开发行的发行对象将按所作的相应调整。最终发行价格及发行数量将由股东大会根据实际情况进行适当调整。

7. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

8. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

9. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

10. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

11. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

12. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

13. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

14. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

15. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

16. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

17. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

18. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

19. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

20. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

21. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

22. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

23. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

24. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

25. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

26. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 500,000 450,000

27. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过450,000万元,拟用于以下投资项目:

序号 项目名称 计划投资(万元) 拟用募集资金投入(万元)

1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000

2 LED芯片封装项目 150,000 150,000

3 补充流动资金 100,000 100,000

合计 50